

Allegato Tecnico

1. Oggetto della fornitura

Oggetto della fornitura è la realizzazione fisica di circuiti integrati monolitici (MMICs) in tecnologia GaN 100nm della fonderia OMMIC (processo D01GH), basati su disegni forniti dal committente (Dipartimento).

Il Committente fornirà in versione elettronica il layout dei singoli MMICs in formato GDS pronti per la fonderia, soddisfacenti le Design Rules della fonderia stessa (DRC verified).

I MMICs da fornire dopo una verifica visuale (*visual inspection*) e relativo taglio (*dicing*) sono riportati nella seguente tabella

Item	ID	Size	Area	Min. # di chip (visually good and dicing)
1	MMIC Chip 1	2.2mm x 5mm	11 mm ²	10
2	MMIC Chip 2	2.2mm x 5mm	11 mm ²	10
3	MMIC Chip 3	2.2mm x 5mm	11 mm ²	10
4	MMIC Chip 4	2.1mm x 5mm	10.5 mm ²	10
5	MMIC Chip 5	2.1mm x 2.5mm	5.25 mm ²	5
Total Area			48.75 mm²	

I chip dovranno essere consegnati al Committente entro **20 settimane** dall'ordine.